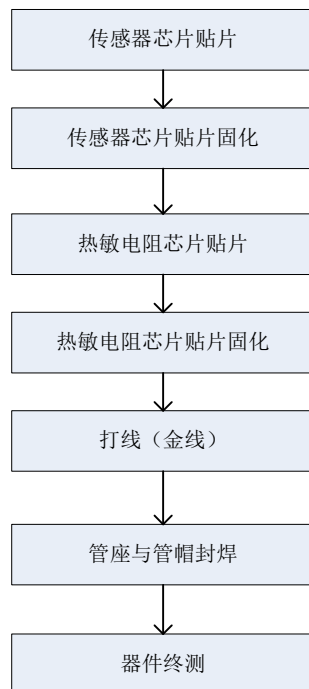


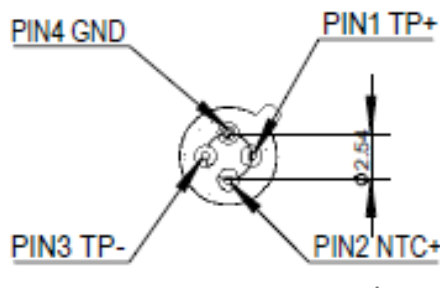
SGXV02红外传感器T046封装工艺流程及要求

1) 封装工艺流程



2) 传感器管壳

我们现在采用的 TO46管壳是 4 Pin，管座图纸如下。



3) 芯片贴片及打线

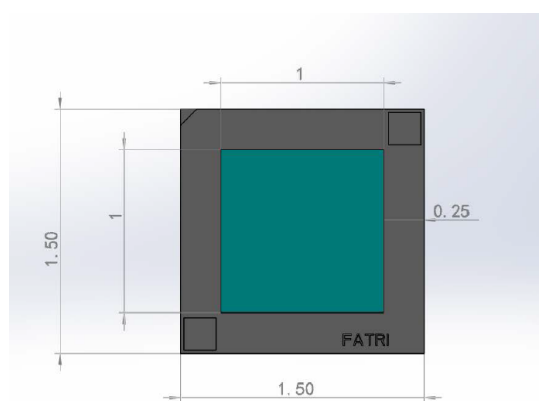
工艺控制：传感器贴片宽度、针头尺寸、导电银浆类型、传感器芯片取片力、贴片力和时间、贴片胶点胶高度、芯片放置位置

a) 贴片要求传感器芯片是 2 个或 4 个边缘点点银浆贴片；而热敏电阻芯片贴片是整个芯片背部都银浆贴片。

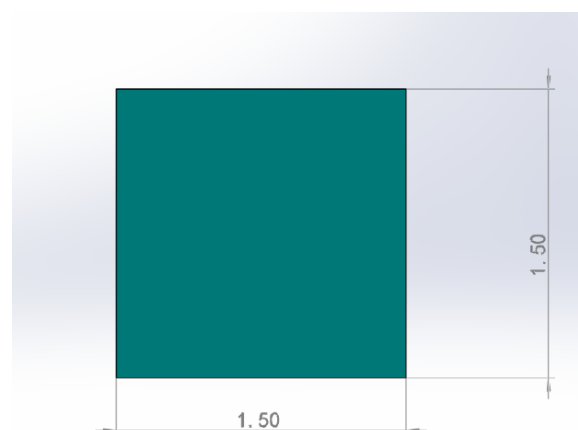
b) 传感器芯片尺寸为 $1.5 \times 1.5 \times 0.75 \text{ mm}^3$ ，热敏电阻芯片尺寸 $0.5 \times 0.5 \times 0.35 \text{ mm}^3$

c) 传感器芯片自动贴片对吸嘴有要求，吸嘴只能吸芯片的外围框架。外围可用吸嘴的框架是 250um。

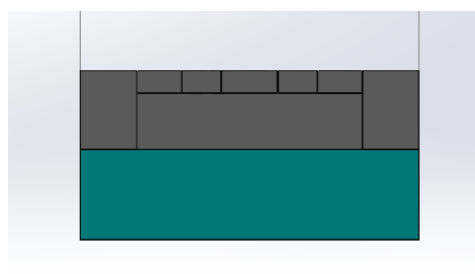
- 芯片结构示意图



芯片正面

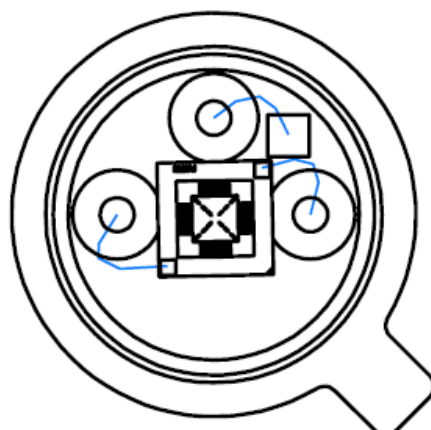


芯片背面



芯片切面

- 芯片贴片结构示意图



3)打线工艺要求

工艺控制：劈刀寿命、第一焊点功率和时间、弧线高度、引线拉力强度，引线键合强度

4)封帽工艺要求

工艺控制：储能焊电压、时间、充 N2